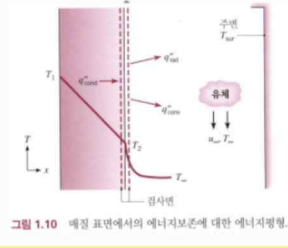


Chapter 1

열전달률 $q [W]$
 열유속 $q'' [W/m^2]$
 단위 부피당 열전달률 $\dot{q} [W/m^3]$
 열전도도 $k [W/m \cdot K]$
 대류 열전달 계수 $h [W/m^2 \cdot K]$

전도 $q_{cond} = -kA \nabla T$
 대류 $q_{conv} = hA(T_s - T_\infty)$
 복사 $q_{rad} = \epsilon \sigma A(T_s^4 - T_{sur}^4)$
 $\epsilon \sigma = 5.67 \times 10^{-8} W/m^2 \cdot K^4$
 표면 방사도 $E = \epsilon \sigma T_s^4$
 코사 $G = \sigma T_{sur}^4$

복사 열전달 계수 (h_r)
 $h_r = \epsilon \sigma (T_s + T_{sur})(T_s^2 + T_{sur}^2)$
 $q_{cond}'' - q_{conv}'' - q_{rad}'' = 0$
 일반적으로 나가는 에너지는 대류 + 복사
 단 액체의 경우 복사가 일어나지 않음



Chapter 2

에너지 평형 방정식
 $\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_s = \dot{E}_{st}$
 에너지 생성항 $\dot{E}_s = \dot{q} dx dy dz$
 에너지 저장항 $\dot{E}_{st} = \rho V C_p \frac{\partial T}{\partial t}$
 $= \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$

열확산 방정식 $\rho k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ 가 q 로 대체 가능
 $\frac{\partial}{\partial x} (k \frac{\partial T}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (k \frac{\partial T}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z} (k \frac{\partial T}{\partial z}) + \dot{q} = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t}$
 $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{\rho C_p}{k} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$
 열확산율 $\alpha = \frac{k}{\rho C_p} \Rightarrow$ 물체의 성질을 나타내는 parameter
 if $C_p \uparrow \Rightarrow$ 열 보기가 잘 돼 열확산이 안 될

열확산 방정식 - 원통형
 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (kr \frac{\partial T}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} (k r^2 \frac{\partial T}{\partial \theta}) + \frac{\partial}{\partial z} (k \frac{\partial T}{\partial z}) + \dot{q} = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t}$
 if 정상상태 $\Rightarrow \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = 0$

원통형 열확산 방정식 유도

$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_s = \dot{E}_{st}$
 $q_r - q_{r+dr} + \dot{q} V = \rho C_p V \frac{\partial T}{\partial t}$
 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (kr \frac{\partial T}{\partial r}) + \dot{q} = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t}$

원통형 이므로 $V = 2\pi r dr$
 $q_r = -k(2\pi r \cdot l) \frac{\partial T}{\partial r}$
 $q_{r+dr} = q_r + \frac{\partial}{\partial r} q_r dr$
 $= q_r + \frac{\partial}{\partial r} (-k \cdot 2\pi r \cdot \frac{\partial T}{\partial r}) dr$

표 2.2 표면(x=0)에서 열확산 방정식 조건

1. 일정한 표면온도 $T(0, t) = T_s$
2. 일정한 표면열유속
 (a) 유한 열유속 $-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = q_s''$
 (b) 단열 또는 절연 표면 $\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0$
3. 대류 표면 조건 $-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = h(T_\infty - T(0, t))$

구형 열확산 방정식 유도

구형은 $V = 4\pi r^2 dr$ 사용
 $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (kr^2 \frac{\partial T}{\partial r}) + \dot{q} = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t}$

$q_r = -k \cdot 4\pi r^2 \cdot \frac{\partial T}{\partial r}$
 $q_r = q_r + \frac{\partial}{\partial r} (-k \cdot 4\pi r^2 \cdot \frac{\partial T}{\partial r}) dr$

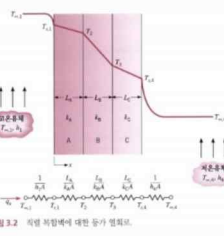
Chapter 3

평판의 온도 분포 (1차원 정상상태, 내부 에너지 X, 면적 고려 X)

k 가 상수일 때 $\frac{\partial}{\partial x} (k \frac{\partial T}{\partial x}) = 0$ 적분 시 $T = C_1 x + C_2$
 경계 조건 $(T)_{x=0} = T_{s1} = C_2 \Rightarrow C_2 = T_{s1}$
 $(T)_{x=L} = T_{s2} = C_1 L + C_2 \Rightarrow C_1 = \frac{T_{s2} - T_{s1}}{L}$
 $\Rightarrow T(x) = \frac{T_{s2} - T_{s1}}{L} x + T_{s1}$

$k = k_0(1 + \beta T) \Rightarrow$ 열전도율이 온도의 함수
 $\frac{\partial}{\partial x} [k_0(1 + \beta T) \frac{\partial T}{\partial x}] = 0$ 적분 시 $k_0(T + \frac{\beta}{2} T^2) = C_1 x + C_2$
 경계 조건을 통해 계산하면
 $T + \frac{\beta}{2} T^2 = [(T_{s2} - T_{s1}) + \frac{\beta}{2}(T_{s2}^2 - T_{s1}^2)] \frac{x}{L} + (T_{s1} + \frac{\beta}{2} T_{s1}^2)$

복합벽의 경우



$q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{L_A}{k_A A} + \frac{L_B}{k_B A} + \frac{L_C}{k_C A} + \frac{1}{h_2 A}}$
 총괄 열전달 계수 U 사용 시
 $q_x = UA \Delta T$ $U [W/m^2 \cdot K]$
 $U = \frac{1}{R_{tot} \cdot A}$ $R_{tot} = \frac{\Delta T}{q} = \frac{1}{UA}$

열저항 \Rightarrow 열 흐름은 전기 흐름과 유사 $V = IR \Rightarrow I = \frac{\Delta V}{R}$

↳ 전도 $q = -kA \frac{dT}{dx} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{L/kA} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{R_t}$ $R_t = \frac{L}{kA} [K/W]$

↳ 대류 $q = hA(T_s - T_\infty) = \frac{T_s - T_\infty}{1/hA} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{R_t}$ $R_t = \frac{1}{hA} [K/W]$

저항은 스프링과 유사

↳ 병렬 $\Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

↳ 직렬 $\Rightarrow R = R_1 + R_2$ if 복사가 있으면 복사 열전달 계수 (h_r) 사용

ex) 대류-전도-대류
 $q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{R_{tot}}$ $R_{tot} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A}$ $h_r = \epsilon \sigma (T_s + T_{sur})(T_s^2 + T_{sur}^2)$

실린더에서의 1차원 열전도

열전도 방정식 $\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (kr \frac{dT}{dr}) = 0$ 적분 시 $T(r) = \frac{C_1}{k} \ln r + C_2$
 $\Rightarrow T(r) = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln(r_1/r_2)} \ln(\frac{r}{r_2}) + T_{s2}$
 열전달률 $q_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(2\pi r L) \frac{dT}{dr}$ $\frac{dT}{dr} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln(r_1/r_2)} \cdot \frac{1}{r}$ 대입
 $\Rightarrow q(r) = 2\pi k L \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln(r_1/r_2)}$ 이 때 $R_t = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k L}$
 대류 $R_t = \frac{1}{2\pi r_2 L h}$

접촉 저항: 물체가 접촉 시에도 표면 조도로 인해 미세 열저항 발생

열에너지 발생이 있는 전도

환(저항 가변) 저항 R_e , 전류 I
 $\dot{E}_s = I^2 R_e$

단위 체적당 열에너지 발생률 $\dot{q} = \frac{\dot{E}_s}{V} = \frac{I^2 R_e}{V}$

평면 벽 $\Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$
 $T(x) = \frac{qL^2}{2k} (1 - \frac{x^2}{L^2}) + \frac{T_{s2} - T_{s1}}{2} \frac{x}{L} + \frac{T_{s1} + T_{s2}}{2}$
 대칭 $T(x) = \frac{qL^2}{2k} (1 - \frac{x^2}{L^2}) + T_s$
 최고 온도 $T(0) = \frac{qL^2}{2k} + T_s$

반지름 방향 계 $\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dT}{dr}) + \frac{\dot{q}}{k} = 0$

$T(r) = \frac{q r^2}{4k} (1 - \frac{r^2}{r_2^2}) + T_s$

원통 내부 발생 열량 = 대류에 의해 뺀 열량
 $\dot{q}(\pi r_2^2 L) = h(2\pi r_2 L)(T_s - T_\infty) \Rightarrow T_s = T_\infty + \frac{q r_2}{2h}$